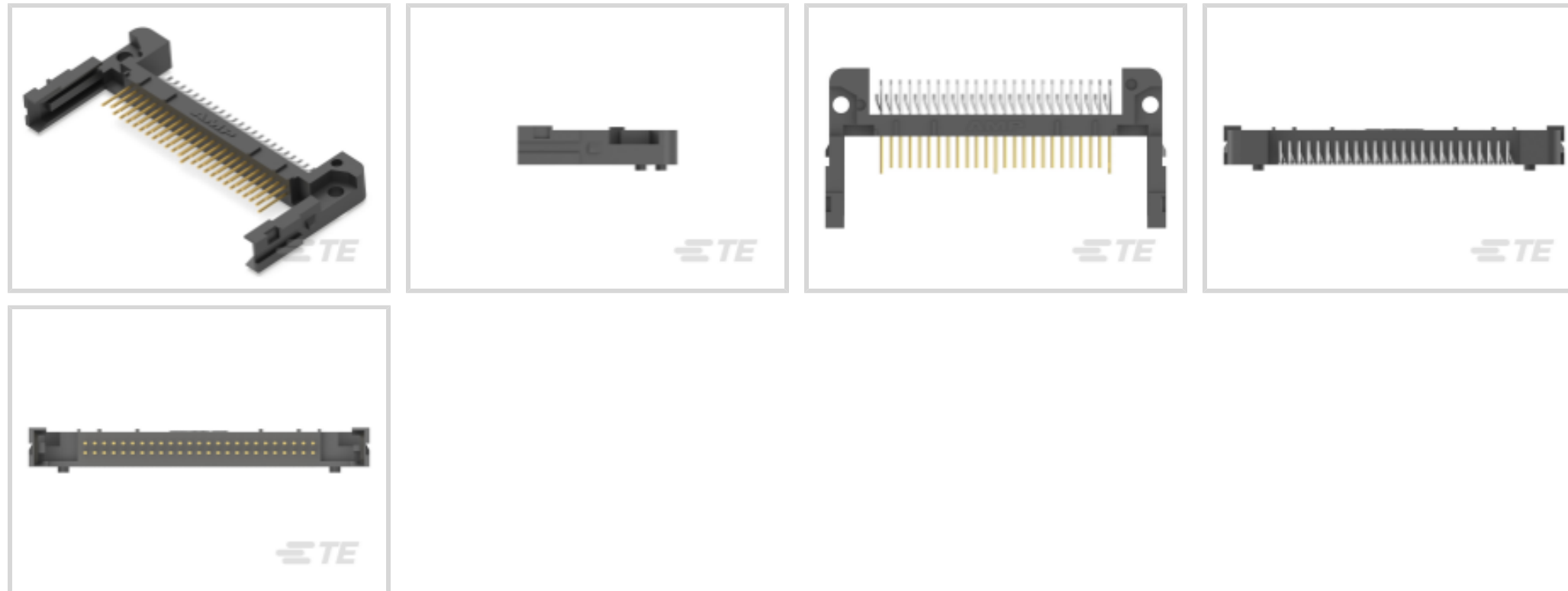


连接器 > PCB 连接器 > 内存卡连接器 > CompactFlash 连接器



PCB 端接方法: 表面贴装

端子布局: 交错

PCB 安装方向: 直角

## 产品特性

### 产品类型特性

|           |       |
|-----------|-------|
| 连接器系统     | 缆到板   |
| 连接器和端子端接到 | 印刷电路板 |

### 结构特性

|          |    |
|----------|----|
| 行数       | 2  |
| 位数       | 50 |
| PCB 安装方向 | 直角 |

### 主体特性

|        |    |
|--------|----|
| 主要产品颜色 | 黑色 |
| 连接器外形  | 低  |

### 接触件特性

|                |            |
|----------------|------------|
|                | 30 $\mu$ m |
| 端子接触部电镀材料      | 金          |
| 端子底板材料         | 镍          |
| PCB 端子端接区域电镀材料 | 锡          |
| 端子基材           | 铍铜合金, 铍铜合金 |
| 端子额定电流 (最大值)   | .5 A       |
| 端子布局           | 交错         |

### 端接特性

|          |      |
|----------|------|
| PCB 端接方法 | 表面贴装 |
|----------|------|

### 机械附件

|         |     |
|---------|-----|
| 连接器安装类型 | 板安装 |
|---------|-----|

### 壳体特性

|      |             |
|------|-------------|
| 外壳材料 | LCP (液晶聚合物) |
|------|-------------|

|          |                 |
|----------|-----------------|
| 中心线 (间距) | 1.27 mm[.05 in] |
|----------|-----------------|

### 尺寸

|           |         |
|-----------|---------|
| PCB 的外形高度 | 3.51 mm |
|-----------|---------|

### 操作/应用

|      |        |
|------|--------|
| 电路应用 | Signal |
|------|--------|

### 行业标准

|          |          |
|----------|----------|
| UL 阻燃性等级 | UL 94V-0 |
|----------|----------|

### 包装特性

|      |      |
|------|------|
| 封装方法 | Reel |
|------|------|

### 产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|  |   |
|--|---|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU   | 符合  |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC  | 符合  |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法 (China RoHS 2, 工业和信息化部携七部委2016年第32号令) | 没有超出阈值的受限材料   |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                                | 欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月 (240)<br>SVHC候选清单的声明更新至: 2021年7月 (219)<br>不含REACH SVHC |
| 卤素含量   | 低卤素 - 每种均质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC                                     |
| 焊接工艺能力   | 回流焊接可达到 260°C   |

#### 产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。

免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

## 客户还购买了



## 文档

### CAD 文件

3D PDF

3D

### 下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_5788667-1\\_O.2d\\_dxf.zip](#)

英文版本

### 下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_5788667-1\\_O.3d\\_igs.zip](#)

英文版本

### 下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_5788667-1\\_O.3d\\_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

